

低温焼結性銅粉

CH-0200L1

Low temperature sintering copper powder



製品概要

Product summary

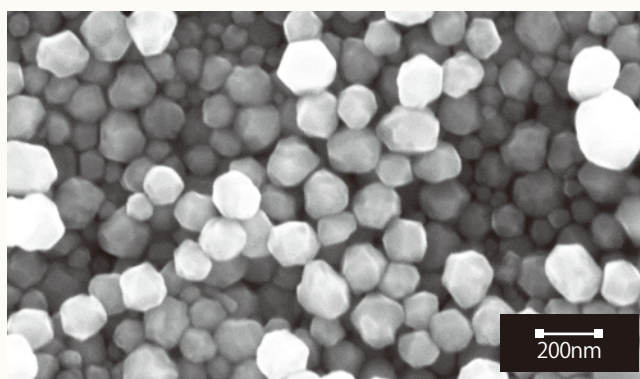
- ◎半導体接合や微細配線などの焼結フィラーとしてご利用頂けます
Used as sintering material for die-bonding and fine wiring.
- ◎低温、短時間焼結により、基板ダメージを抑えた焼成が可能です
Reduce heat damage by sintering at 190 degrees C in a short time.

製品外観

Product appearance



◆ CH-0200L1 ◆

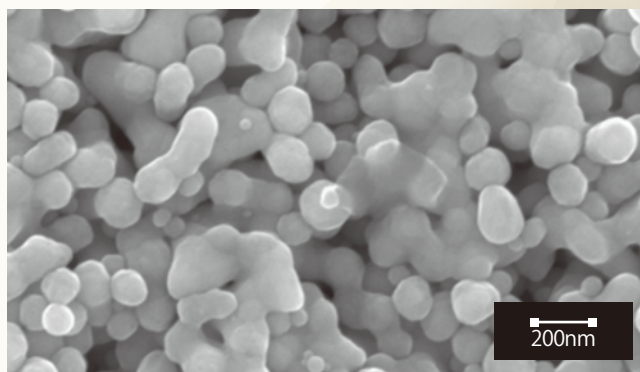


◆ SEM ◆

製品データ(代表値)

Product data

		CH-0200 (既存品)	CH-0200L1 (開発品)
比表面積 [m ² /g]		3.5	4.2
粒度分布 [μm]	D50	0.28	0.21
化学分析 [wt%]	C	0.6	0.7
	O	1.1	1.0



◆ 190°C × 10min × in N₂ ◆